

特点:

- 较低的插入损耗: 最大值 3.0dB
- 良好的带内驻波比: 典型值 1.5:1
- 高阻带抑制: 最小值 50dB @ $f_0 \pm 140\text{MHz}$
- SMT 封装
- 工作温度: $-55 \sim +85^\circ\text{C}$
- 封装尺寸: $22 \times 16.6 (\text{max}) \times 5 (\text{max}) \text{mm}^3$
- 产品执行标准为 SJ20764-1999

图片:



性能参数: ($T_A=25^\circ\text{C}$, 50 Ω 系统)

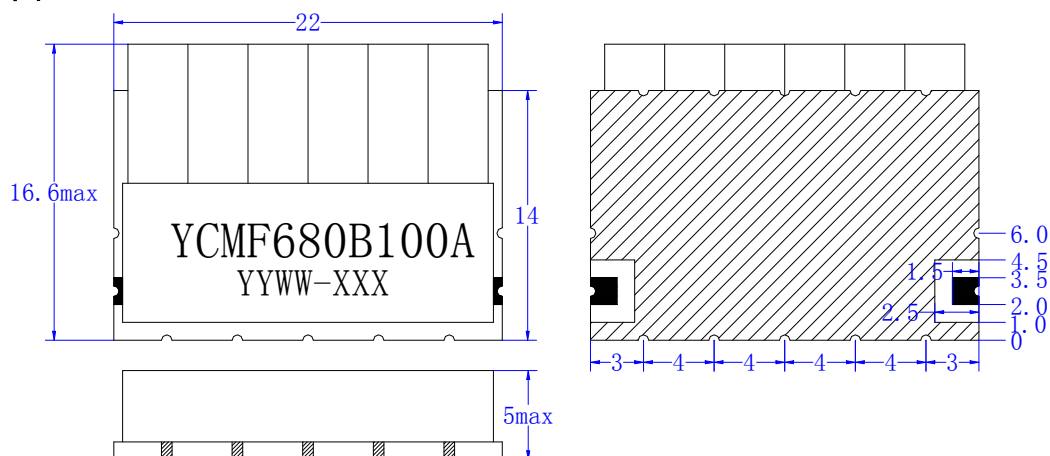
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
通带频率	f_c		630		730	MHz	全温
带内波动	BR	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{\text{TEST}}=630 \sim 730\text{MHz}$			1.0	dB	全温
插入损耗	IL				3.0	dB	全温
输入带内驻波比	VSWR _i	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{\text{TEST}}=630 \sim 730\text{MHz}$		1.5:1	2.0:1		全温
输出带内驻波比	VSWR _o			1.5:1	2.0:1		全温
阻带抑制	SR ₁	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{\text{TEST}}=1 \sim 540\text{MHz}$	58	60		dB	全温
	SR ₂	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{\text{TEST}}=540 \sim 580\text{MHz}$	38	40		dB	全温
	SR ₃	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{\text{TEST}}=780 \sim 820\text{MHz}$	30	33		dB	全温
	SR ₄	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{\text{TEST}}=820 \sim 1360\text{MHz}$	50	60		dB	全温
质量	m				5.0	g	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
贮存温度	$-55 \sim +100$	$^\circ\text{C}$	输入射频功率	30.0	dBm

封装外形图:

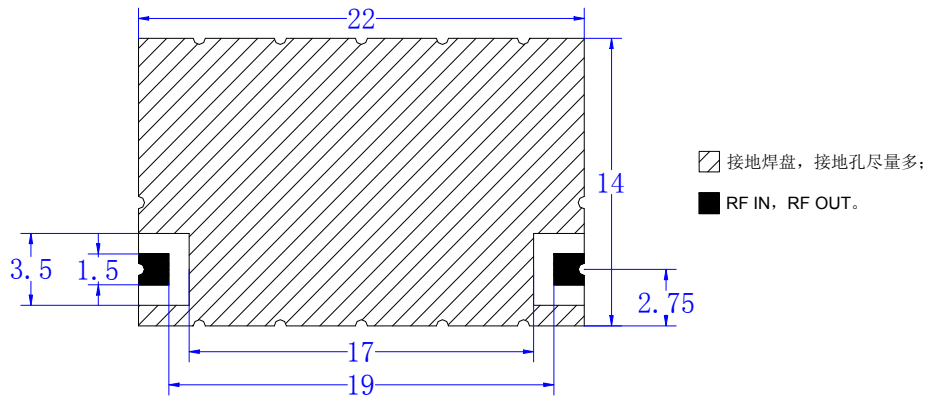
单位: mm 公差: $\pm 0.3\text{mm}$



表面处理: 陶瓷介质镀银, 屏蔽罩镀镍, PCB 镀金。

注: 本产品内部有陶瓷片耦合电容, 在涂覆三防时, 请勿将三防漆流入屏蔽罩内。

推荐焊盘图:



字符标志:

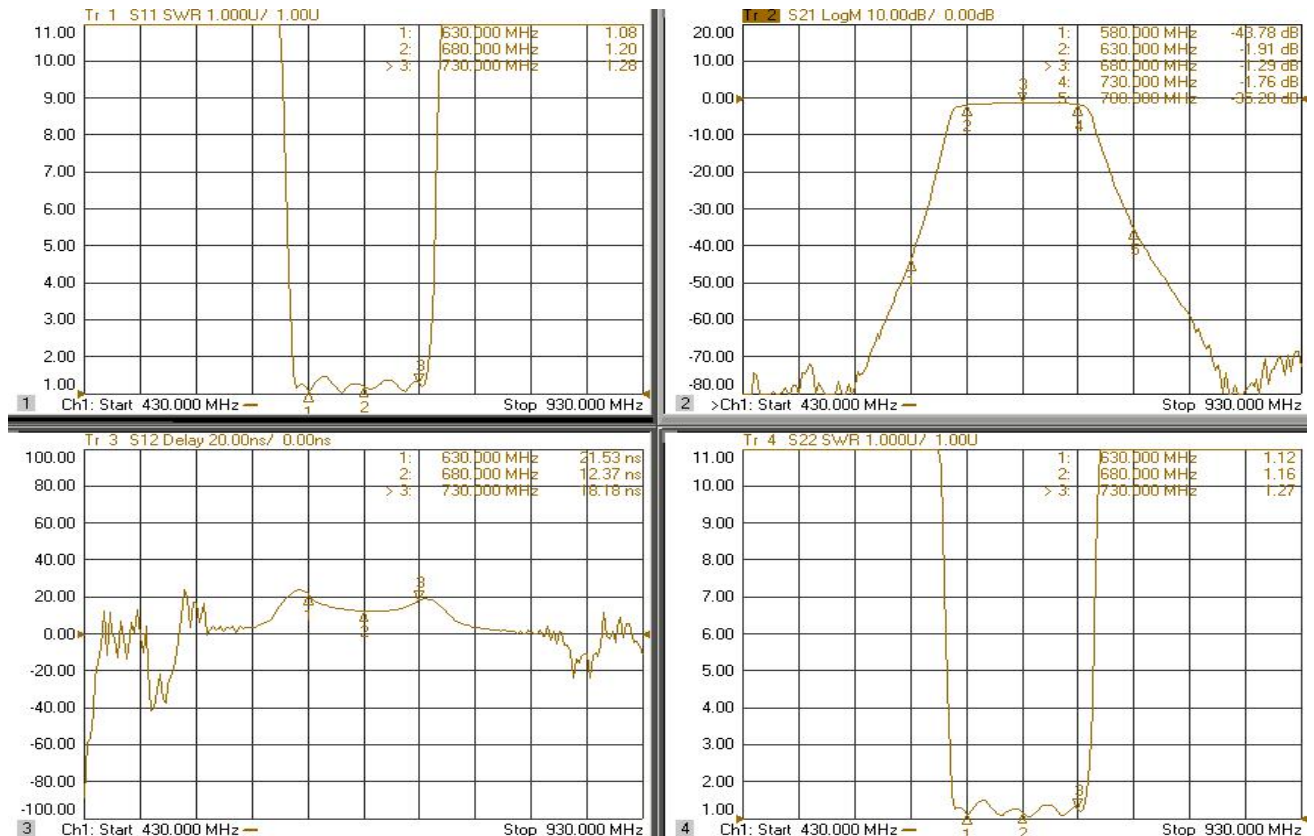
YCMF680B100A	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义:

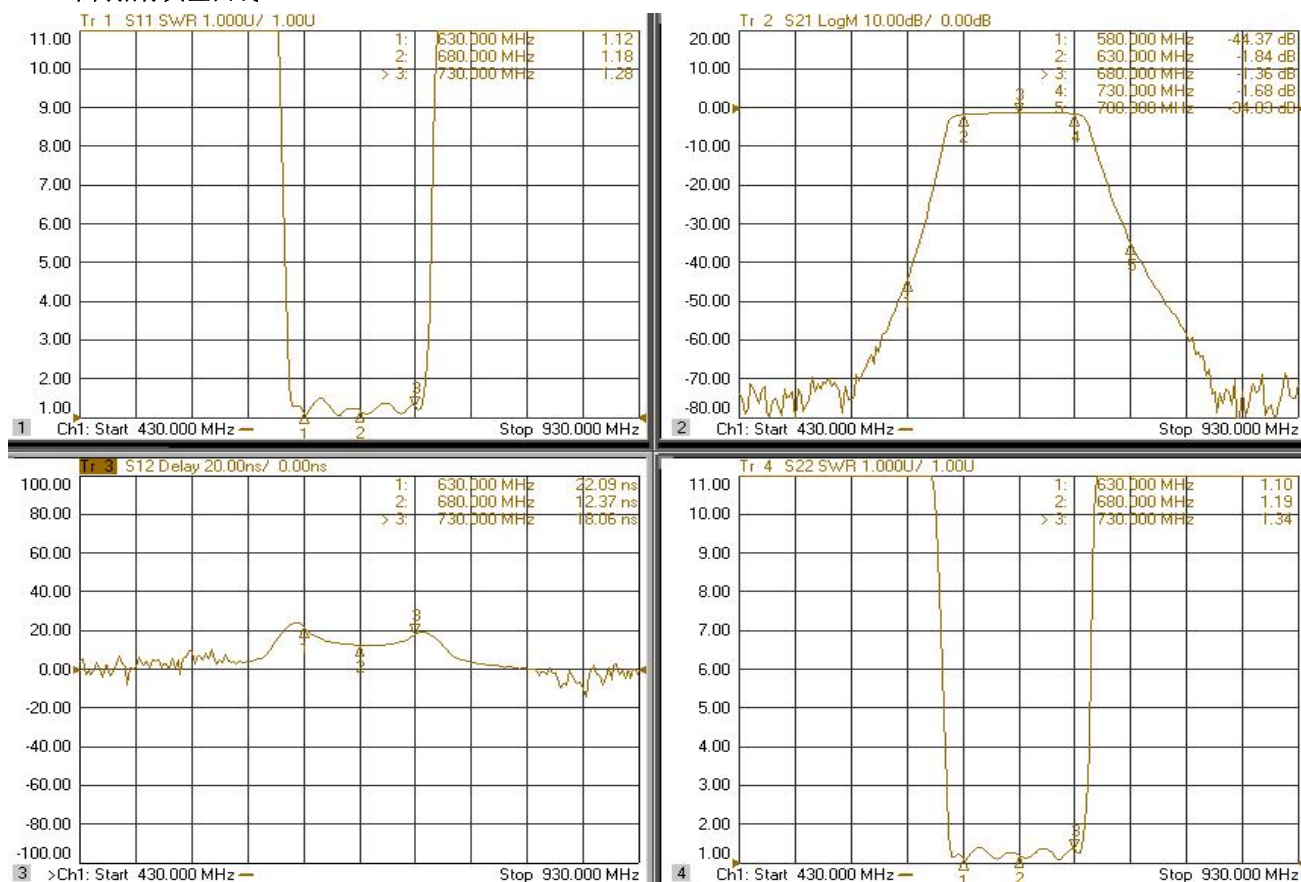
接口标识	接口说明
■	RF IN, RF OUT (可互换)
▨	GND

测试曲线:

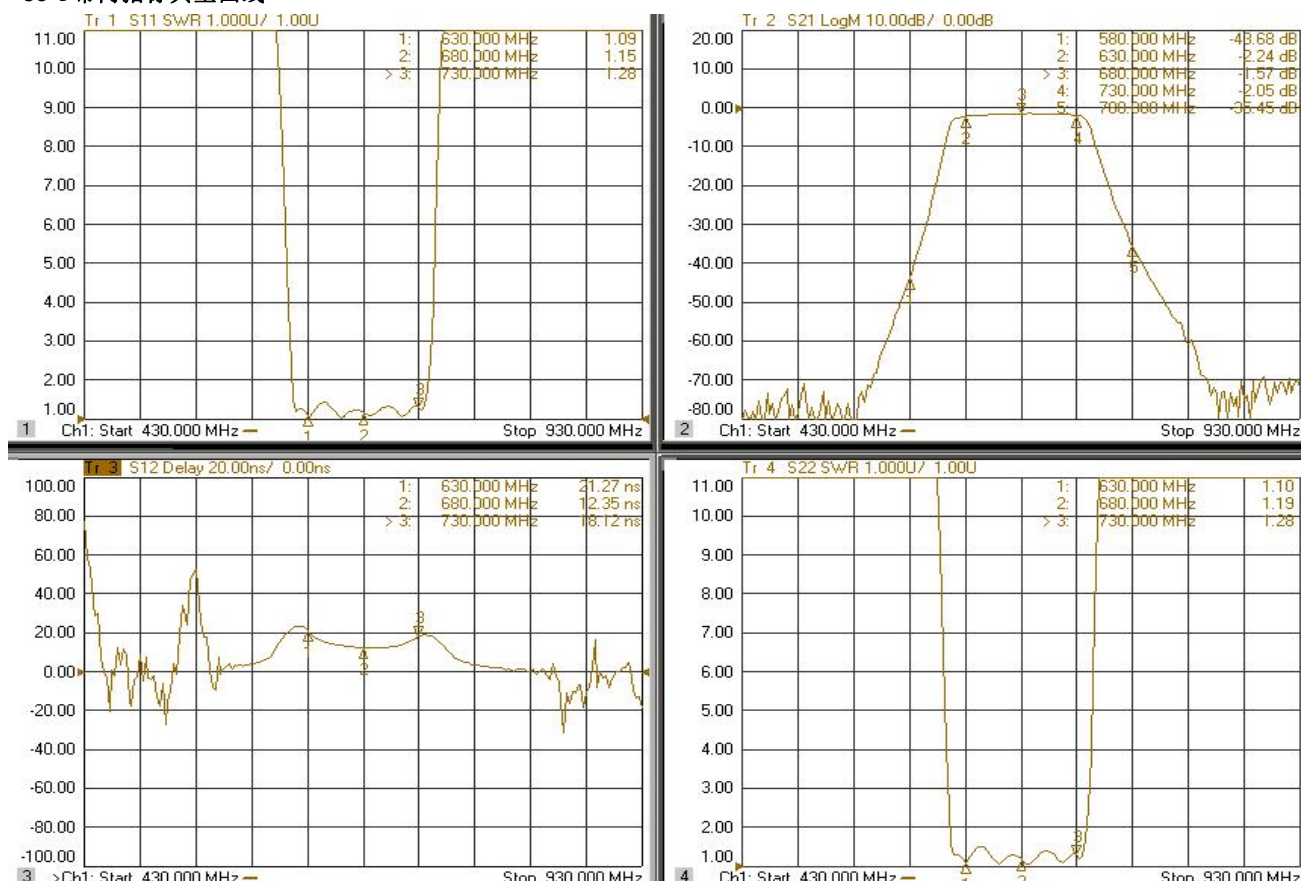
+25℃带内指标典型曲线



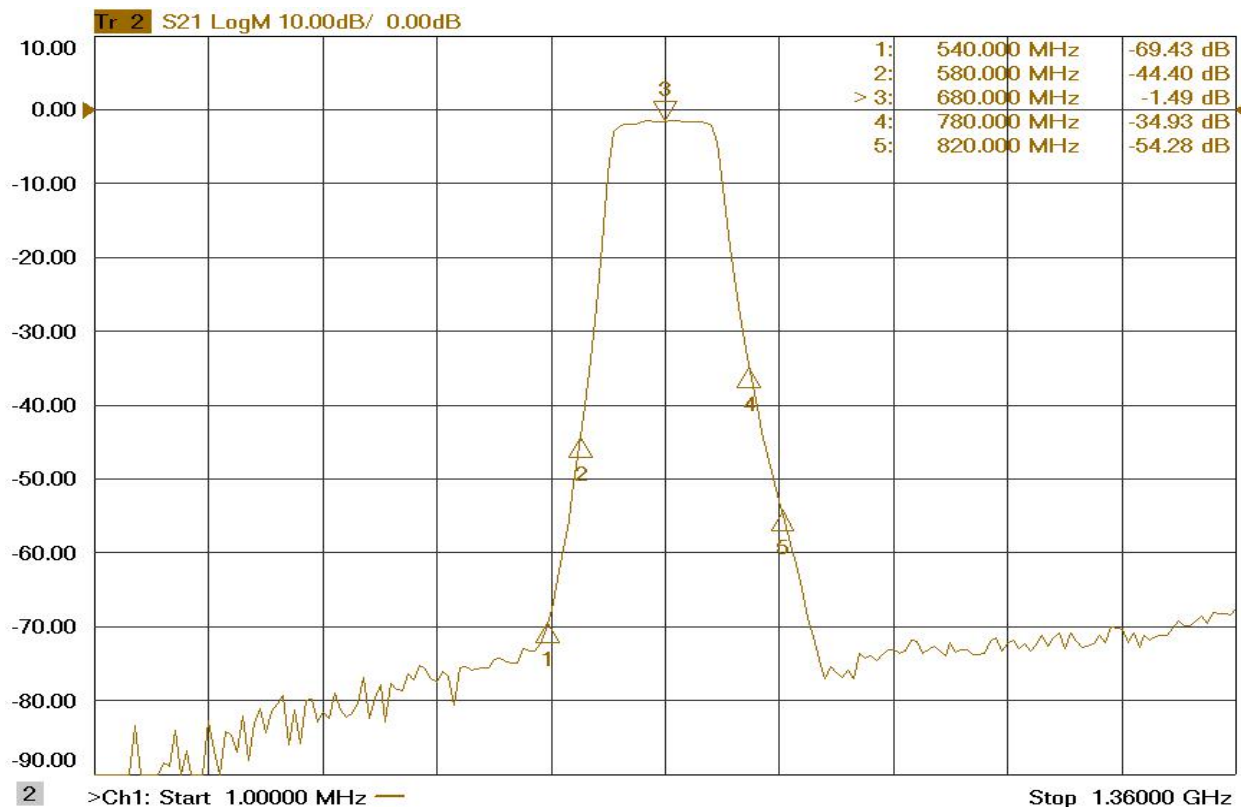
-55℃带内指标典型曲线



+85℃带内指标典型曲线

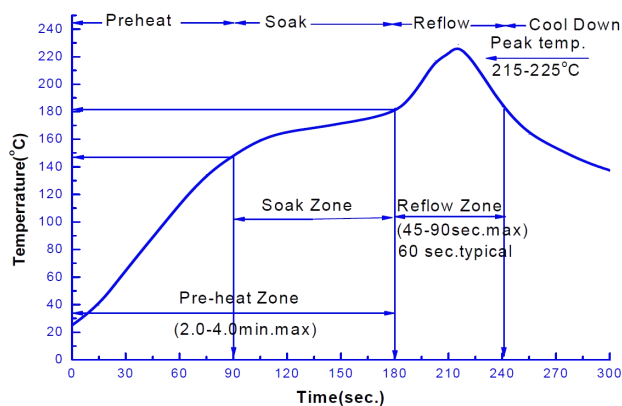


带外抑制典型曲线



产品使用注意事项:

1. 产品使用时请保证接地良好。
2. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，推荐采用采用组份 $\geq 2\%$ 的含银焊膏回流焊接，回流温度推荐曲线:



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230°C。

3. 产品在存储时需采用密封包装，存放条件：温度 10~35°C，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
4. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。本产品内部有陶瓷片耦合电容，在涂覆三防时，请勿将三防漆流入屏蔽罩内。
5. 其他使用注意事项参考成都宇熙《微波介质陶瓷滤波器产品使用说明》。